

半导体封测产业境外投资项目申请报告

产品名称	半导体封测产业境外投资项目申请报告
公司名称	鸿晟信合研究网
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530)
联系电话	18513627985 18513627985

产品详情

半导体封测产业境外投资项目申请报告

【全新修订】：2023年8月

【出版机构】：中赢信合研究网

【内容部分有删减·详细可参中赢信合研究网出版完整信息！】

【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)

【服务形式】：文本+电子版+光盘

【联系人】：何晶晶 顾佳

【报告目录】

一、总论

(一) 项目背景

1、项目基本信息

项目名称：

项目性质：

项目承办单位：

法定代表人：

项目负责人：

项目主要成员：

项目投资地址：

项目经营范围：

2、可行性研究报告编制依据

(二) 项目概况

1、拟建项目规模与目标

2、主要建设条件

3、项目投入总资金及效益情况

4、主要技术经济指标

(三) 问题与建议

1、项目资金来源问题

2、项目服务流程及技术获取问题

3、项目上报问题

二、半导体封测境外投资项目投资方情况

（一）主要投资方基本情况

（包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况；）

（二）主要投资方基本经营情况

（包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标；）

（三）主要投资方相关实力和优势分析

（主要投资方相关实力和优势分析，包括在国内外投资类似项目简要情况）

（四）其他投资方简要情况

（包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。）

三、半导体封测境外投资项目必要性及所在行业预测分析

（一）项目相关行业国内外情况及预测

1、国内外市场发展现状

2、行业未来发展预测

（二）项目投资目的和意义

1、项目背景及投资环境情况

2、项目对各投资方的必要性和意义

（包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等）

3、项目投资社会意义

（包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等）。

四、半导体封测境外投资项目背景及投资环境情况

（一）项目背景

包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等；

（二）投资环境情况

包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况；

（三）项目的外部意见及影响

包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生

的影响等。

五、半导体封测境外投资项目内容

（一）场址选择

1、建设地点

2、建设条件及规模

（二）项目实施进度

1、项目实施进度安排

2、项目实施进度表

（三）项目服务流程及技术

1、主要业务及流程

2、技术支持

六、半导体封测境外投资项目相关配套条件落实情况

（一）交通

（二）相关配套条件

- 1、供水
- 2、供电
- 3、通信及信息系统设计方案
- 4、通风采暖工程
- 5、动力设计方案
- 6、防雷设计
- 7、防尘设计
- 8、维修设施
- 9、仓储设施

（三）节能措施

- 1、节能规范
- 2、设计原则
- 3、节能方案
- 4、节能措施

（四）节水措施

七、半导体封测境外投资项目环境影响评价

(一) 场址环境条件

(二) 项目对环境的影响

(三) 环境保护措施方案

1、设计依据

2、环保措施

(四) 环境影响评价

八、半导体封测境外投资项目劳动安全卫生与消防

(一) 劳动安全与职业卫生

1、设计依据

2、设计执行的主要标准

3、设计内容及原则

4、职业安全

5、职业卫生

6、辅助卫生用室

7、职业安全卫生机构

(二) 消防

- 1、设计依据
- 2、总平面布置
- 3、建筑部分
- 4、电气部分
- 5、给排水部分

九、半导体封测境外投资项目组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

- 1、项目法人组建方案
- 2、管理机构组织方案

（二）人力资源配置

- 1、工作班次
- 2、项目劳动定员
- 3、职工工资福利
- 4、员工来源及招聘方案
- 5、员工培训

十、半导体封测境外投资项目投资估算

（一）投资估算依据

（二）项目总投资估算

1、固定资产投资估算

2、流动资金估算

3、项目总投资

4、项目投入总资金

（三）项目合作方案

包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容；

（四）资金筹措

包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

（五）投资使用计划

1、固定资产投资使用计划

2、流动资金使用计划

（六）借款偿还计划

十一、半导体封测境外投资项目财务效益指标评价

（一）计算依据及相关说明

1、项目测算参考依据

2、项目测算基本设定

（二）总成本费用估算

1、直接成本

2、工资及福利费用

3、折旧及摊销

4、修理费

5、财务费用

6、其它费用

7、总成本费用

（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

1、销售收入

2、销售税金及附加费用

（四）损益及利润及分配

（五）盈利能力分析

1、投资利润率，投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

3、项目财务现金流量表

4、项目资本金财务现金流量表

(六) 盈亏平衡分析

(七) 敏感性分析

(八) 经济社会效益分析

1、经济效益

2、社会效益

十二、半导体封测境外投资项目项目风险分析

(一) 项目风险因素识别

1、国别风险

2、法律及政策风险

3、市场风险

4、建设风险

5、环保风险

6、劳工风险

7、其他风险

（二）项目风险防控措施

1、国别风险防控措施

2、法律及政策风险防控措施

3、市场风险防控措施

4、建设风险防控措施

5、环保风险防控措施

6、劳工风险防控措施

7、其他风险防控措施

十三、半导体封测境外投资项目其他事项

（一）项目是否存在需要解决的问题；

（二）实施项目的下一步工作计划。

十四、半导体封测境外投资项目附件目录

（一）《境外投资项目核准暂行管理办法》（国家发展改革委第21号令）第十七条要求随项目申请报告提供的有关文件；

1、公司董事会决议或相关的出资决议；

2、证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件；

3、银行出具的融资意向书；

4、以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件；

(二) 需要提供的其他相关证明文件。